

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5974880号
(P5974880)

(45) 発行日 平成28年8月23日(2016.8.23)

(24) 登録日 平成28年7月29日(2016.7.29)

(51) Int.Cl.

F 1

H01L 23/473 (2006.01)
H01L 23/40 (2006.01)H01L 23/46
H01L 23/40Z
Z

請求項の数 6 (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2012-271420 (P2012-271420)
 (22) 出願日 平成24年12月12日 (2012.12.12)
 (65) 公開番号 特開2014-116546 (P2014-116546A)
 (43) 公開日 平成26年6月26日 (2014.6.26)
 審査請求日 平成26年11月10日 (2014.11.10)

(73) 特許権者 000006013
 三菱電機株式会社
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
 (74) 代理人 100082175
 弁理士 高田 守
 (74) 代理人 100106150
 弁理士 高橋 英樹
 (74) 代理人 100148057
 弁理士 久野 淑己
 (72) 発明者 村田 大輔
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内
 (72) 発明者 吉松 直樹
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】半導体装置及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

冷却フィンのベース板の実装部上に半導体素子を実装し、前記半導体素子と前記実装部を樹脂で封止して半導体モジュールを形成する工程と、

前記実装部から横方向に延びる前記ベース板の第1の延設部を冷却ジャケットの固定部の差込口に差し込む工程と、

前記第1の延設部を前記差込口に差し込んだ状態で、前記実装部から前記第1の延設部とは反対方向に延びる前記ベース板の第2の延設部を前記冷却ジャケットに固定して、前記半導体モジュールを前記冷却ジャケットに取り付ける工程とを備え、

前記固定部において、前記第1の延設部が差し込まれる部分の下方に溝を設けることを特徴とする半導体装置の製造方法。 10

【請求項 2】

前記第2の延設部を前記冷却ジャケットにネジ止めすることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記固定部の前記第1の延設部との接触面に突起を設け、

前記第1の延設部を前記差込口に差し込む際に前記第1の延設部と前記突起が接触しないようにし、

前記第2の延設部を固定する際に前記突起で前記第1の延設部を押さえ付けることを特徴とする請求項1又は2に記載の半導体装置の製造方法。 20

【請求項 4】

冷却ジャケットと、

前記冷却ジャケットに取り付けられた半導体モジュールとを備え、

前記半導体モジュールは、ベース板を含む冷却フィンと、前記ベース板の実装部上に実装された半導体素子と、前記半導体素子と前記実装部を封止する樹脂とを有し、

前記冷却ジャケットは、差込口を持つ固定部を有し、

前記実装部から横方向に延びる前記ベース板の第1の延設部が前記固定部の前記差込口に差し込まれ、

前記実装部から前記第1の延設部とは反対方向に延びる前記ベース板の第2の延設部が前記冷却ジャケットに固定され、

前記固定部において、前記第1の延設部が差し込まれる部分の下方に溝が設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

前記第2の延設部は前記冷却ジャケットにネジ止めされていることを特徴とする請求項4に記載の半導体装置。

【請求項 6】

前記固定部の前記第1の延設部との接触面に突起が設けられ、

前記突起が前記第1の延設部を押さえ付けていることを特徴とする請求項4又は5に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、半導体モジュールを冷却ジャケットに取り付けた半導体装置及びその製造方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

自動車や電車等のモータを制御するインバータや発電、回生用コンバータなどに、半導体素子と冷却フィンを樹脂で封止したトランスマーモールド型の半導体モジュールが用いられる。この半導体モジュールを冷却ジャケットに取り付ける際に、従来は半導体モジュールの樹脂封止部から延びるベース板の四隅を冷却ジャケットにネジ止めしていた（例えば、特許文献1参照）。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

【特許文献1】特開2005-286020号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

しかし、ベース板にネジ穴を設けるスペースが必要になるため、半導体モジュールのサイズが大きくなる。このため、製造装置と搬送装置が大型化するという問題があった。

【0005】

本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は半導体モジュールを縮小して製造装置と搬送装置の大型化を防ぐことができる半導体装置及びその製造方法を得るものである。

【課題を解決するための手段】**【0006】**

本発明に係る半導体装置の製造方法は、冷却フィンのベース板の実装部上に半導体素子を実装し、前記半導体素子と前記実装部を樹脂で封止して半導体モジュールを形成する工程と、前記実装部から横方向に延びる前記ベース板の第1の延設部を冷却ジャケットの固定部の差込口に差し込む工程と、前記第1の延設部を前記差込口に差し込んだ状態で、前

10

20

30

40

50

記実装部から前記第1の延設部とは反対方向に延びる前記ベース板の第2の延設部を前記冷却ジャケットに固定して、前記半導体モジュールを前記冷却ジャケットに取り付ける工程とを備え、前記固定部において、前記第1の延設部が差し込まれる部分の下方に溝を設けることを特徴とする。

【発明の効果】

【0007】

本発明により、半導体モジュールを縮小して製造装置と搬送装置の大型化を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

10

【0008】

【図1】本発明の実施の形態1に係る半導体装置を示す上面図である。

【図2】図1のI-I'Iに沿った断面図である。

【図3】本発明の実施の形態2に係る半導体装置を示す断面図である。

【図4】本発明の実施の形態3に係る半導体装置を示す断面図である。

【図5】本発明の実施の形態4に係る半導体装置を示す上面図である。

【図6】図5のI-I'Iに沿った断面図である。

【図7】本発明の実施の形態4に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

20

本発明の実施の形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を参照して説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場合がある。

【0010】

実施の形態1.

図1は、本発明の実施の形態1に係る半導体装置を示す上面図である。図2は図1のI-I'Iに沿った断面図である。冷却ジャケット1にトランスファーモールド型の半導体モジュール2が取り付けられている。

【0011】

半導体モジュール2は、ベース板3とその下方に設けられた複数のフィン4を含む冷却フィン5と、ベース板3の実装部3a上に実装された半導体素子6と、半導体素子6と実装部3aを封止する樹脂7とを有する。ベース板3は、実装部3aと、実装部3aから横方向に延びる延設部3bと、実装部3aから延設部3bとは反対方向に延びる延設部3cとを有する。延設部3b, 3cは半導体モジュール2の四角形状の樹脂7の四隅から反対方向に延びている。

【0012】

冷却ジャケット1の上面には、差込口8を持つ固定部9と、冷却水路10と、Oリング用溝11とが設けられている。ベース板3の延設部3bが固定部9の差込口8に差し込まれている。ベース板3の延設部3cが冷却ジャケット1にネジ12によりネジ止めされて固定されている。複数のフィン4は冷却ジャケット1の冷却水路10に収納されている。水漏れを防ぐためOリング用溝11内にOリング13が用いられている。

30

【0013】

続いて、本実施の形態の製造方法を説明する。まず、冷却フィン5のベース板3の実装部3a上に半導体素子6を実装し、半導体素子6と実装部3aを樹脂7で封止して半導体モジュール2を形成する。

【0014】

次に、実装部3aから横方向に延びるベース板3の延設部3bを冷却ジャケット1の固定部9の差込口8に差し込む。次に、延設部3bを差込口8に差し込んだ状態で、実装部3aから延設部3cとは反対方向に延びるベース板3の延設部3cを冷却ジャケット1にネジ止めして固定して、半導体モジュール2を冷却ジャケット1に取り付ける。

40

50

【0015】

本実施の形態では、冷却フィン5のベース板3の延設部3bを冷却ジャケット1の固定部9の差込口8に差し込むことにより、延設部3bを冷却ジャケット1にネジ止めする場合に比べて延設部3bの長さを短くすることができる。この結果、半導体モジュール2を縮小できるため、製造装置と搬送装置の大型化を防ぐことができる。また、延設部3bのネジ止めを無くすることで部品点数を削減できる。

【0016】

実施の形態2.

図3は、本発明の実施の形態2に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態1の構成に加えて、固定部9において、延設部3bが差し込まれる部分の下方に溝14が設けられている。

10

【0017】

この溝14により延設部3bを固定部9に斜めに深く差し込むことができるため、差し込み時に冷却フィン5と冷却ジャケット1の接触を防ぐことができる。この結果、冷却フィン5の面積を増やして冷却性能を向上させることができる。

【0018】

実施の形態3.

図4は、本発明の実施の形態3に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態1の構成に加えて、固定部9の延設部3bとの接触面に突起15が設けられている。この突起15が延設部3bを押さえ付けている。組み立て時において、延設部3bを差込口8に差し込む際に延設部3bと突起15が接触しないようにする。そして、延設部3cをネジ止めする際に突起15で延設部3bを押さえ付ける。これにより、冷却フィン5のベース板3と冷却ジャケット1の密着性を向上させることができる。

20

【0019】

なお、上記の機能を生じるように突起15の高さを調整する必要がある。突起の断面形状はベース板3に食い込みやすい三角形状が好ましいが、半円状、四角形状でもよい。

【0020】

実施の形態4.

図5は、本発明の実施の形態4に係る半導体装置を示す上面図である。図6は図5のI-Iに沿った断面図である。実施の形態1とは異なり、半導体モジュール2のベース板3の延設部3b, 3cにネジ穴が設けられていない。そして、半導体モジュール2が冷却ジャケット1に外付け部品16により取り付けられている。具体的には、ベース板3の延設部3b, 3cが外付け部品16により冷却ジャケット1に押し付けられてネジ止めされて固定されている。外付け部品16はネジ12により冷却ジャケット1に固定されている。外付け部品16の断面形状はS字状である。

30

【0021】

ベース板3の延設部3b, 3cを直接ネジ止めするのではなく外付け部品16で固定するため、延設部3b, 3cにネジ穴を設ける必要が無い。従って、延設部3b, 3cの長さを短くすることができる。この結果、半導体モジュール2を縮小できるため、製造装置と搬送装置の大型化を防ぐことができる。また、延設部3bのネジ止めを無くすることで部品点数を削減できる。

40

【0022】

図7は、本発明の実施の形態4に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。この例では外付け部品16の断面形状は長方形である。ベース板3の延設部3b, 3cを冷却ジャケット1に押し付けて固定できるものであれば、外付け部品16の断面形状はS字状に限らず、長方形や正方形でもよい。

【0023】

なお、半導体素子6は、珪素によって形成されたものに限らず、珪素に比べてバンドギャップが大きいワイドバンドギャップ半導体によって形成されたものでもよい。ワイドバンドギャップ半導体は、例えば、炭化珪素、窒化ガリウム系材料、又はダイヤモンドであ

50

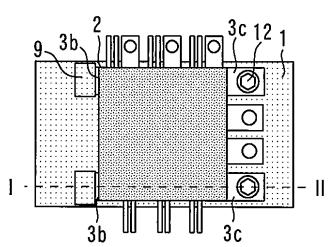
る。このようなワイドバンドギャップ半導体によって形成された半導体素子6は、耐電圧性や許容電流密度が高いため、小型化できる。この小型化された素子を用いることで、この素子を組み込んだ半導体モジュール2も小型化できる。また、素子の耐熱性が高いため、冷却フィン5を小型化でき、冷却部を空冷化できるので、半導体装置を更に小型化できる。また、素子の電力損失が低く高効率であるため、半導体モジュール2を高効率化できる。

【符号の説明】

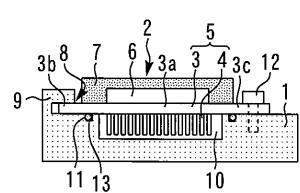
【0024】

- 1 冷却ジャケット、2 半導体モジュール、3 ベース板、3a 実装部、3b, 3c 延設部、5 冷却フィン、6 半導体素子、7 樹脂、8 差込口、9 固定部、14 溝、15 突起、16 外付け部品

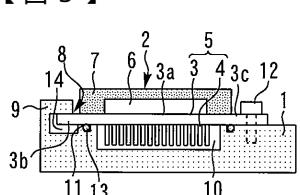
【図1】



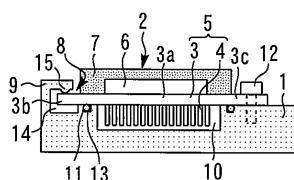
【図2】



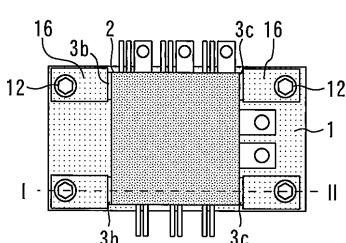
【図3】



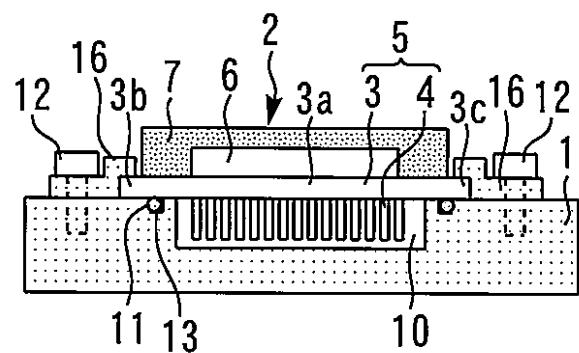
【図4】



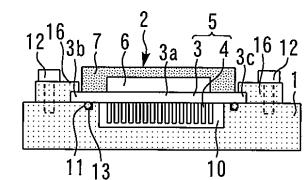
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 碓井 修

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内

審査官 木下 直哉

(56)参考文献 特開2005-302886(JP,A)

特開2005-302882(JP,A)

実開昭56-154054(JP,U)

特開2000-082774(JP,A)

特開2001-035982(JP,A)

特開2008-270295(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 23/34 - 23/473